

03BCK



半导体激光模组

03BCK是杏林睿光半导体AW系列多功能激光模组，TO封装光纤耦合输出，具有体积小、光斑均匀、功率稳定、高可靠性等特点。单模光纤接受定制。

主要功能特点

- ◆ 体积小
- ◆ 光斑均匀
- ◆ 可做单模输出产品
- ◆ 波长可选

应用

- 医疗美容
- 指示光
- 化学分析
- 激光加工

技术参数 (25°C)

封装形式		03BCK (单模)					03BCK (多模)	
中心波长 (nm)		405	450	520	638	650	638	650
光学	连续输出功率 P_{op} (mW)	50	50	50	60	60	130	130
	波长公差 (nm)	± 10						
	光谱宽度 (FWHM) $\Delta\lambda$ (nm)	<3						
	波长随温度特性 $\Delta\lambda/\Delta T$ (nm/°C)	0.3						
电学	阈值电流 I_{th} (mA)	40	22	60	50	60	60	60
	工作电流 I_{op} (mA)	180	150	240	260	260	240	260
	工作电压 V_{op} (V)	5	5	7	2.5	2.5	2.3	2.3
	微分效率 η_{es} (W/A)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.7	0.7
光纤	光纤芯径 D_{core} / 包层直径 D_{clad} (μm)	4/125, 6/125, 9/125					105/125	
	数值孔径 NA	0.14					0.22	
	光纤长度 L (cm)	100±10 (可定制)						
	连接器	FC/PC, SMA905						

- 注：1. 其它功率可接受定制。
2. 可提供650nm红光指示光。
3. 可定制激光防反射功能。
4. 以上表格内所有数据均为室温25°C环境下测试所得的典型值，最终数据以出厂测试报告为准。

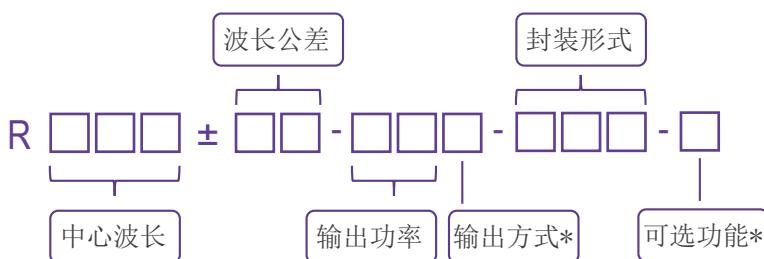
其他参数

参数	工作温度 (°C)	工作相对湿度 (%)	存储温度 (°C)	存储相对湿度 (%)	引脚焊接温度 (max/°C)
最小	10	-	-20	-	-
最大	30	75	70	90	250(10Sec.)

产品型号一览表

封装形式	波长 (nm)	功率 (mW)	型号
03BCK	405	50	R405±10-50mWF-03BCK-S
	450	50	R450±10-50mWF-03BCK-S
	520	50	R520±10-50mWF-03BCK-S
	638	60	R638±10-60mWF-03BCK-S
	650	60	R650±10-60mWF-03BCK-S
	638	130	R638±10-130mWF-03BCK-M
	650	130	R650±10-130mWF-03BCK-M

产品型号命名规则



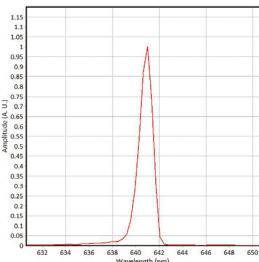
*输出方式: F - 光纤耦合输出

*可选功能: S - 单模光纤

M - 多模光纤

R - 防反800~1100nm

产品特性图

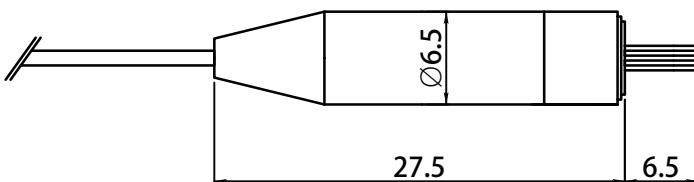


光谱图



光斑图

机械尺寸图 单位: mm



引脚	功能
1	激光器 (-)
2	外壳
3	激光器 (+)



注: 引脚定义以实际出厂数据为准

